



2026年6月9日

株式会社日立製作所

執行役社長兼 CEO 徳永 俊昭

(コード番号：6501)

(上場取引所：東・名)

## Hitachi Investor Day 2026 資料公開に関するお知らせ(コネクティブインダストリーズ事業戦略)

株式会社日立製作所は、6月10日(水)15時00分から開催する「Hitachi Investor Day 2026」の資料を公開しましたので、お知らせします。

別添資料： コネクティブインダストリーズ事業戦略

### 報道機関お問い合わせ先

株式会社日立製作所

経営戦略統括本部

グローバルブランドコミュニケーション本部

グローバルコミュニケーション部

03-3258-1111

### IR 関係お問い合わせ先

株式会社日立製作所

インベスター・リレーションズ本部

03-5208-9323

**HITACHI**

# Hitachi Investor Day 2026

## コネクティブインダストリーズ事業戦略

2026年6月10日

株式会社日立製作所

執行役専務

コネクティブインダストリーズセクターCEO

網谷 憲晴

# 網谷 憲晴

株式会社日立製作所 執行役専務  
コネクティブインダストリーズセクター CEO

入社後、交通システム事業での輸送・信号システム等の設計に従事  
中国の鉄道プロジェクトなど、数々の海外交通システム事業をリード

英国Hitachi Rail Europeを含め、鉄道ビジネスユニットのCOOとして  
グローバルな鉄道事業の経営を指揮

本社の経営企画室長として全社的な経営戦略に携わる

ビルシステムビジネスユニットCEOとして事業全体を統括

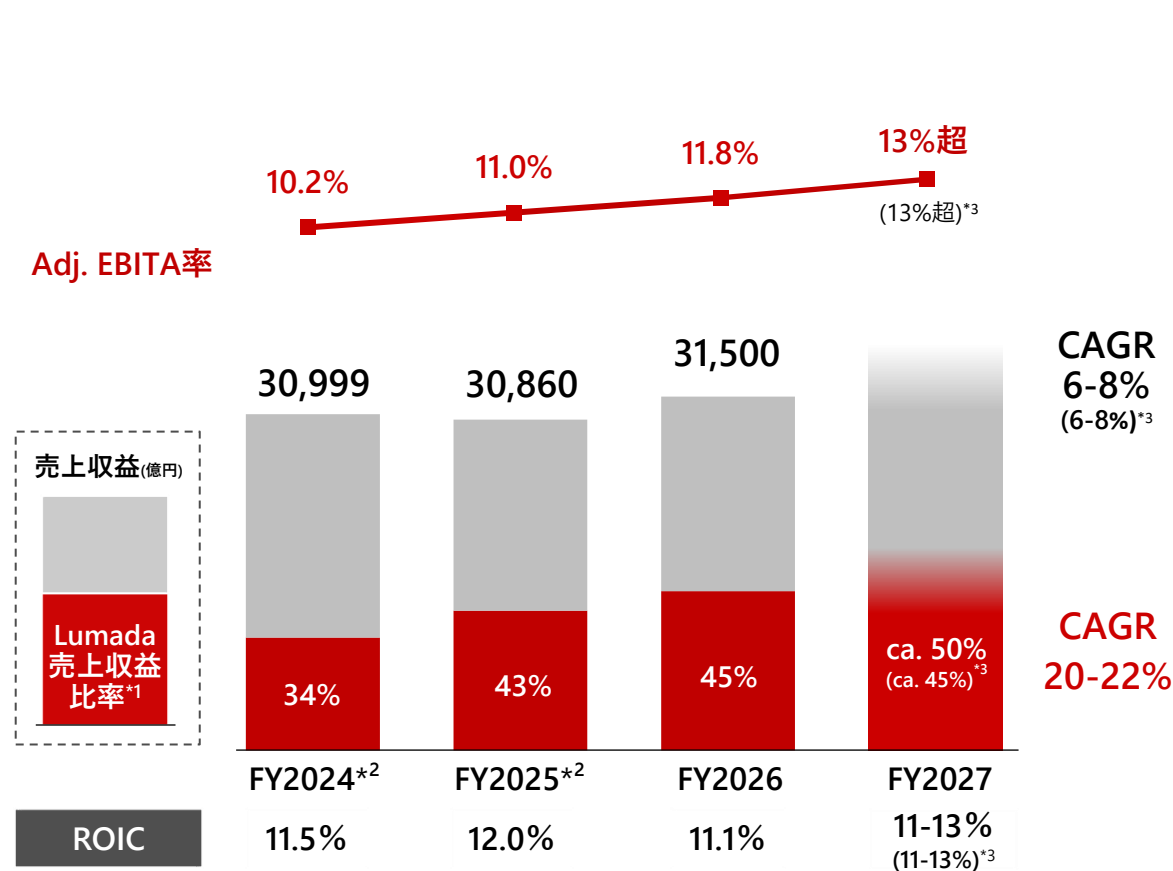
鉄道、ビルシステム、経営企画など、現場の指揮から経営戦略まで幅広い分野を歴任

昨年度よりコネクティブインダストリーズセクターCOO兼アーバンシステムビジネスユニット  
CEOとして、HMAX for Buildingsをはじめとした事業のデジタル化をけん引

"強いプロダクト×磨き上げたドメインナレッジ×フィジカルAI" で、グローバルでの産業分野の変革に挑戦

1. Inspire 2027の進捗状況 / 2025年度の振り返り
2. CIセクターのめざす姿
3. フィジカルAI事業を軸とした成長戦略
4. まとめ

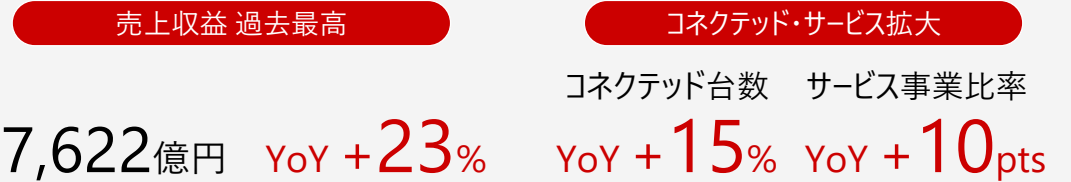
# AI需要を捉えたLumadaの力強い成長で利益率をさらに向上



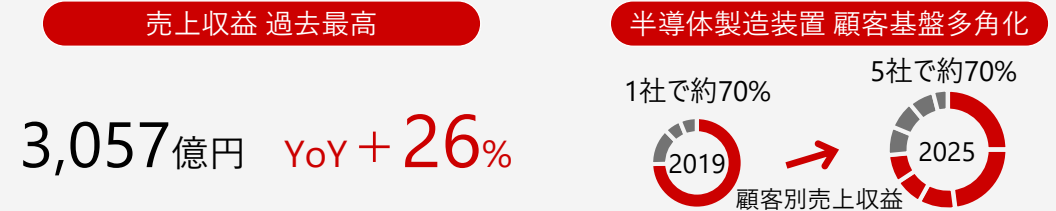
DC: Data Center UPS: Uninterruptible Power Supply  
 \*1 新報告セグメントから一部構造改革事業除いた売上にに基づき算出  
 \*2 FY2024-FY2025の売上収益、Adj. EBITA率、ROICは新報告セグメントに基づきリステート値  
 \*3 ( ) 内の数字は、Hitachi Investor Day 2025(2025年6月11日時点)公表値。新報告セグメントに基づきリステート  
 \*4 データセンター設備、昇降機、産業用HVAC、産業機器(コンプレッサ等)など、高い信頼性が要求される社会インフラ・施設向け事業領域  
 \*5 ヘルスケア事業(診断・治療事業) + 医薬品製造事業

## FY2025 成果

### 1. ファシリティ事業\*4：DC需要を捉えUPSなど関連サービス拡大



### 2. 半導体事業：AI需要の拡大を捉え顧客基盤を多角化・成長



### 3. ライフサイエンス事業\*5：診断・製薬プロセスがAIにより革新



1. Inspire 2027の進捗状況 / 2025年度の振り返り
2. **CIセクターのめざす姿**
3. フィジカルAI事業を軸とした成長戦略
4. まとめ

# インダストリー領域におけるフィジカルAI事業のリーディングカンパニーをめざす

Time to Market

生産効率向上・品質確保

エネルギー効率向上

ゼロダウンタイム

フィジカルAI

Digital Services  
HIMAX™

Physical World  
Operational Data

ドメイン  
ナレッジ

Feedback

現場の実運用を熟知した暗黙知・形式知

Digitalized Assets

プロダクト

高信頼プロダクトの豊富なインストールベース

高度な計測技術で世の中に存在しないデータを創出

2-2. フィジカルAIによるCIセクターの成長モデル

強いプロダクトをベースとしたフィジカルAIで、顧客のTime to Marketを短縮

技術の複雑化による顧客課題の変化

半導体 検証時間

50%増<sup>\*1</sup>

遺伝学的検査・診断の種類

約189倍<sup>\*2</sup>  
2010-2022

バイオ医薬品の効果確認試験

11%長期化<sup>\*3</sup>

顧客・パートナー協創の深化による  
データ活用の高度化

計測+制御のフィジカルAI実装



複数の計測装置・データの組合せ



計測技術のさらなる進化

向

Why Hitachi?

Time to Marketの短縮



\*1 McKinsey 半導体開発~製造における過去数年間でのテスト・検証時間の増加率 \*2 NIH Genetic Testing Registry 米国で利用可能な遺伝学的検査・診断メニュー数の2010年-2022年比較

\*3 McKinsey / Tufts CSDD 2011~2015年と2016~2021年に実施されたバイオ医薬品臨床試験の平均期間の比較

1. Inspire 2027の進捗状況 / 2025年度の振り返り
2. CIセクターのめざす姿
3. **フィジカルAI事業を軸とした成長戦略**
4. まとめ

# AI投資が旺盛な領域に経営資源を集中し、フィジカルAI事業により成長

## ファシリティ

顧客市場  
CAGR 2025-2030  
**12%**  
2030 : 201兆円

売上収益  
**7,622**億円

売上CAGR  
**16%**

## 半導体

顧客市場  
CAGR 2025-2030  
**13%**  
2030 : 240兆円

売上収益  
**3,057**億円

売上CAGR  
**15%**

## 医療診断

顧客市場  
CAGR 2025-2030  
**10%**  
2030 : 52兆円

売上収益<sup>\*1</sup>  
**2,854**億円

売上CAGR<sup>\*1</sup>  
**11%**

## 医薬品製造

顧客市場  
CAGR 2025-2030  
**10%**  
2030 : 120兆円

売上収益  
**637**億円

売上CAGR  
**17%**

顧客市場：Grand View Research等市場レポートより算出 売上収益：FY2025 売上CAGR：FY2025-FY2030

\*1 売上収益、売上CAGRはヘルスケア事業(診断・治療事業)

3-2. ファシリティ領域におけるフィジカルAI

コネクテッド数グローバルトップクラスの昇降機とフィジカルAIで運用効率を最適化

FY2025  
売上収益 **7,622**億円

FY2025  
Adj. EBITA率 **16%**

FY2025-FY2030  
売上CAGR **16%**

Digitalized Assets

コネクテッド昇降機

昇降機コネクテッド台数・率

**グローバルトップクラス\*1**  
(65万台)



空調機器



データセンター向け  
UPS



フィジカルAI バリュー

設備運用・施設管理の最適化

HMAX for Buildings

ビル運営の最適化ソリューション

BuilMirai \*2



- 昇降機のメンテナンス/オペレーション効率化 (予兆保全・管制制御・混雑緩和、高運行効率)
- ファシリティ運用の最適化 (空調、産業機械、セキュリティ、エネルギー、ロボット連携)

使用エネルギー

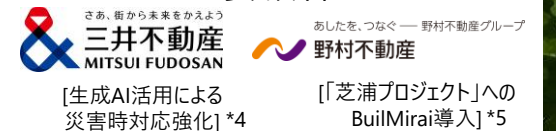
約**16%**削減\*3

施設管理コスト

約**3%**／棟改善\*3

顧客・サービス拡大

主要顧客



[生成AI活用による  
災害時対応強化]\*4

[「芝浦プロジェクト」への  
BuilMirai導入]\*5

パートナー・サービス展開

協創パートナー



[AI・デジタルソリューションで協創]

Bosch空調機器(**300万台**\*6)とつなぎ  
エネルギー最適化

ファシリティ市場  
(AI・ソフトウェア領域)

CAGR **22%**

2025-2030  
市場規模 約5兆円(2030)\*7

\*1 日立調べ \*2 「BuilMirai」は株式会社日立製作所の日本における登録商標です \*3 日立試算値 \*4 ニュースリリース：小規模言語モデル(SLM)を活用したオフライン型災害対策支援システムの開発・検証を開始(2026年4月15日)

\*5 ニュースリリース：「芝浦プロジェクト」で導入するビルOSとして日立のビルIoTソリューション「BuilMirai」を採用(2023年12月11日) \*6 海外で過去15年に据え付けられた日立ブランドVRF室外機(推定) \*7 Modor Intelligence

3-3. 半導体製造領域におけるフィジカルAI

グローバルNo.1の計測装置を起点にフィジカルAIで半導体製造の生産性を向上

FY2025 売上収益 **3,057** 億円      FY2025 Adj. EBITA率 **17%**      FY2025-FY2030 売上CAGR **15%**

Digitalized Assets

CD-SEM



高精度計測で品質基準データ取得

グローバルシェア

約**76%**<sup>\*1</sup>

- 世界トップクラス**2nm**計測技術
- 最先端プロセスにおける業界標準

フィジカルAI バリュー

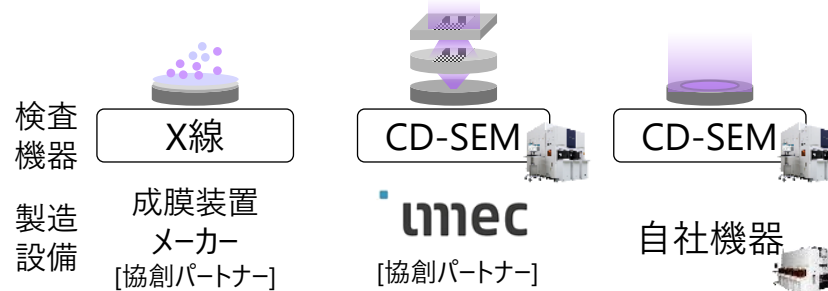
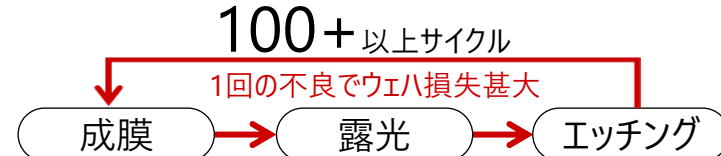
成膜・露光・エッチング工程一体での生産最適化

ExTOPE<sup>\*2</sup>  
IoT統合プラットフォーム

保守支援AI  
計測・検査向け

Recipe AI<sup>\*3</sup>  
加工条件生成AI

前工程の**8割**<sup>\*4</sup>を占める中核工程



利用事例

開発期間

約**50%**  
短縮

稼働率

約**90%**  
維持・向上

顧客・サービス拡大

主要顧客・協創パートナー

**SAMSUNG**

[半導体製造における  
デジタルソリューション開発パートナー]  
装置データ連携で  
生産性向上と工程最適化を加速

**intel.**

[AX加速に向けた戦略的協業]  
高精度データ活用によるプロセス最適化  
製造歩留り向上・高品質化を実現

半導体製造市場  
(AI・ソフトウェア領域)

CAGR **22%**

2025-2030  
市場規模 3兆円 (2030)<sup>\*5</sup>

\*1 日立調べ \*2 「ExTOPE」は株式会社日立ハイテクの日本、米国、欧州、英国、中国、台湾、韓国における登録商標です \*3 「Recipe AI」は株式会社日立製作所の日本における商標登録です

\*4 半導体製造装置(前工程)市場における主要工程の構成比(Technavioの比率に基づく) \*5 DATAINTELO、MarketsandMarkets、Technavio、Virtue Market Research、market.us

# グローバルNo.1の体外診断装置とフィジカルAIで、診断・治療最適化に貢献

FY2025  
売上収益 **2,854**億円

FY2025  
Adj. EBITA率 **15%**

FY2025-FY2030  
売上CAGR **11%**

## Digitalized Assets

### 生化学・免疫分析装置



グローバルシェア  
**No.1**<sup>\*1</sup>

cobas® pro integrated solutions  
cobasはRoche社の登録商標です

グローバル**9**万台以上<sup>\*2</sup>の  
豊富なインストールベース

### 遺伝子検査装置

(キャピラリー電気泳動DNAシーケンサー)



グローバルシェア  
**No.1**<sup>\*1</sup>

Applied Biosystems SeqStudio Flex  
Applied Biosystemsは、Applied Biosystems LLCの登録商標です  
SeqStudioは、Thermo Fisher Scientific Inc.の登録商標です

## フィジカルAI バリュー

### 高精度な複数診断提供での確かな治療選択と医療最適化

HMAX for Healthcare

Digital Cancer Board支援

体外診断の**8割**<sup>\*3</sup>を占める検査領域への貢献

診断データをつなげて病理診断・治療へ拡大、最適ながん治療へ



協創パートナー

GENCURIX | invivoscribe

[がん分子診断]

検査標準化

生化学・免疫検査数

の**10**億人/年  
データ創出

検査自動化

生化学検査を起点とした  
検査工程の自動化範囲

**10**倍以上

## 顧客・サービス拡大

主要顧客・協創パートナー



[生化学・免疫分析で協創] [遺伝子検査で協創]



[大規模臨床検査センター主要顧客]

生化学分析に加え、他社分析装置含む  
ワークフロー最適化・自動化システムを提供

診断市場  
(AI・ソフトウェア領域)

CAGR **21%**

2025-2030  
市場規模 1.1兆円 (2030)<sup>\*4</sup>

業績数値はヘルスケア事業(診断・治療事業) \*1 日立調べ \*2 cobas全機種が生化学・免疫分析装置 現稼働台数 \*3 体外診断装置市場における主要検査領域の構成比(Technavioの比率に基づく) \*4 Grand View Research

3-5. 医薬品製造領域におけるフィジカルAI (今後のさらなる成長領域)

Lab to Fabを一気通貫でつなぎ、プロセス開発から商用生産へ量産化を加速

FY2025  
売上収益

637億円

FY2025

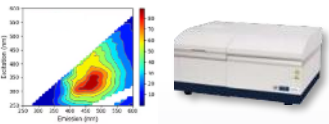
Adj. EBITA率 14%

FY2025-FY2030

売上CAGR 17%

Digitalized Assets

分光分析装置(蛍光指紋)



細胞・DNA等の異常を早期検知

培養装置



AI解析・シミュレーション活用

ラインビルド



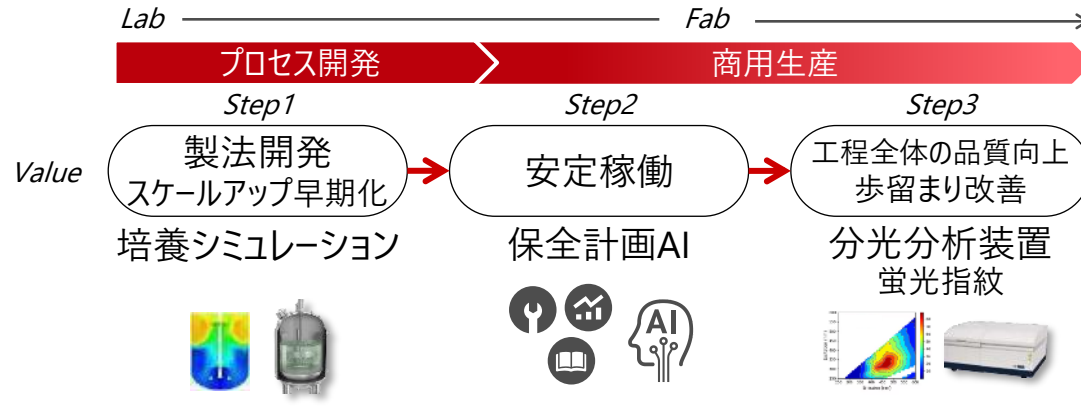
業界屈指の生産・品質管理  
デジタルソリューション

フィジカルAI バリュー

プロセス立上げを起点にLabからFabまで一貫支援

HMAX for Biopharma

バイオ医薬品製造の高度化支援



リスク低減によるスケールアップ期間

> 30%短縮

保全計画AIによる最適化効果

約10%/工場 生産機会貢献\*1

顧客・サービス拡大

主要顧客・協創パートナー



FUJIFILM

医薬企業へサービス展開

医薬品産業顧客基盤

約 350社

製法開発から量産品質の  
安定化までを大幅に短縮する  
Lab to Fab自動化ソリューションを実現

医薬品製造市場  
(AI・ソフトウェア領域)

CAGR 17%

2025-2030  
市場規模 0.6兆円 (2030)\*2

\*1 日立試算値 \*2 EXACTITUDE CONSULTANCY

# AI半導体でNo.1のプロダクトをさらに強化、協業パートナーと共にフィジカルAI事業拡大

## エッジAI半導体を開発

多様なプロダクトへ実装を加速\*1



\*2

- 最先端GPU比10倍以上の電力効率
- 専用サーバー不要でリアルタイム解析
- 様々な産業機械や産業ロボットを智能化

## 1. AI半導体を実装し、No.1のプロダクトをさらに強化

多様な現場データをリアルタイムに解析、生産性を飛躍的に改善



## 2. AI半導体を協業パートナーのプロダクトに実装、協創深化

複数のプロダクト・データの組合せにより、顧客価値を拡大

## 3. カスタマーゼロによるソリューションの検証・創出を加速

AI半導体を活用し自社の製造プロセスを革新、顧客に展開

\*1 ニュースリリース：日立、HMAX Industry を支えるフィジカルAIの基盤技術としてエッジAI半導体を開発(2026年4月24日)

\*2 本画像は生成AIを使用して作成されています

### 3-7. フィジカルAI事業拡大に向けたR&D強化

# フィジカルAI事業を拡大させる製品の強化と知能化

研究開発投資

FY2022-2024  
3年累計

2,750億円

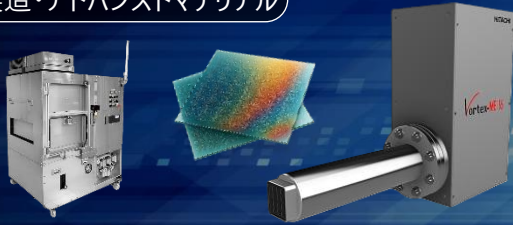


FY2025-2027  
3年累計

3,700億円

## 計測技術の進化

半導体製造・アドバンスドマテリアル



先端材料の量産化を加速  
X線計測 多素子SDD\*1

## フィジカルAI イネーブラー

共通



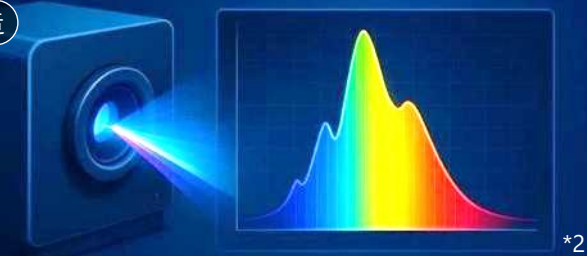
製品の知能化  
エッジAI半導体のレパートリー拡充

## 製品の進化



データセンター用製品強化  
SiC素子採用UPS・高効率空冷チラー

医薬品製造



高い計測感度に基づく品質向上  
新レーザー分光技術

\*1 シリコンドリフト検出器 \*2 本画像は生成AIを使用して作成されています

共通

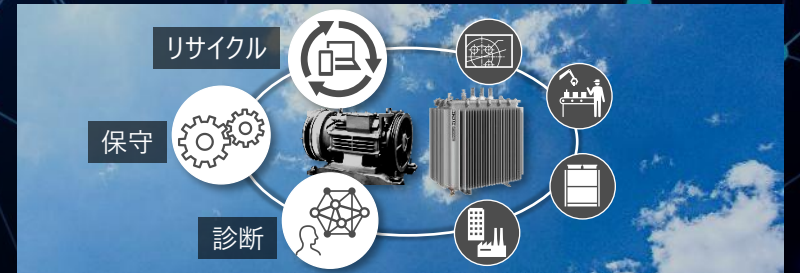


エッジAI半導体でロボット自律化  
ロボットメーカーとの協業推進

リサイクル

保守

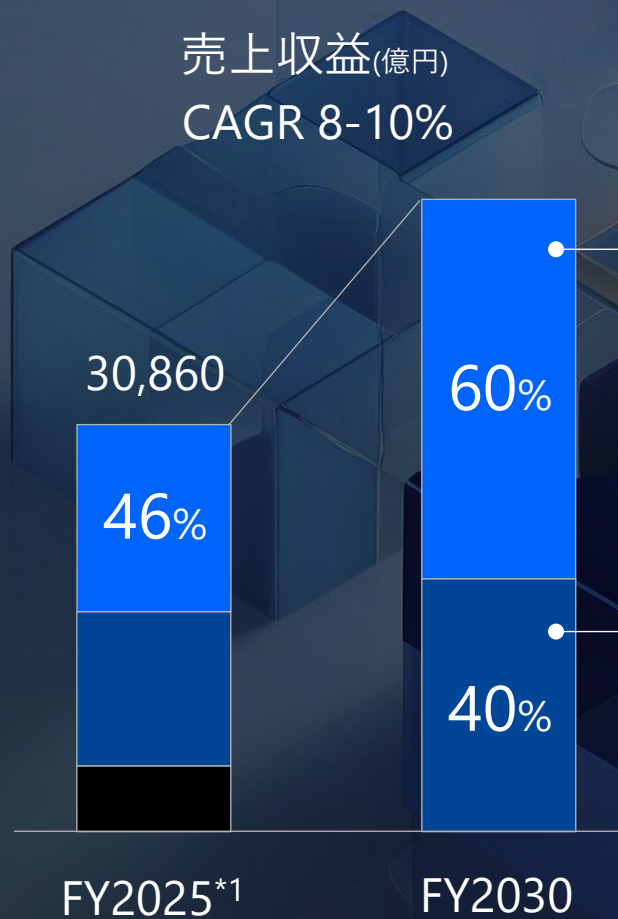
診断



グリーン製品の拡大  
高効率製品とサーキュラーエコノミー

### 3-8. フィジカルAIによる成長に向けたポートフォリオ変革

## フィジカルAIを軸とした事業ポートフォリオ構築と次なるグローバルトッププロダクト創生



#### 1. グローバルトッププロダクトを中核としたフィジカルAI事業拡大

ファシリティ、半導体、医療診断、医薬品製造の各事業が牽引

##### 注力領域での重点投資

- 計測ポートフォリオの拡充
- OTの強化 (複数計測データを組み合わせたフィジカルAIのエンジニアリング力)

#### 2. 次なるグローバルトッププロダクト創生によるフィジカルAI事業のさらなる拡大

データセンター  
高消費電力対応 冷却・UPS

ロボティクス  
エッジAIオートメーション

アドバンスドマテリアル  
最先端計測装置

サーキュラーエコノミー  
グリーンプロダクト、トレーサビリティ

#### 3. Non-Lumada事業の構造改革

2026年4月 家電事業の新会社株式80.1%のノジマへの譲渡を発表  
ベストオーナーへの承継で事業価値最大化

\*1 FY2025は新報告セグメントに基づくリステート値

1. Inspire 2027の進捗状況 / 2025年度の振り返り
2. CIセクターのめざす姿
3. フィジカルAI事業を軸とした成長戦略
4. **まとめ**

# Inspire 2027は順調に進捗、フィジカルAI事業拡大で売上成長率6-8%をめざす

- 強いプロダクトを起点としたフィジカルAI事業への明確なビジネスフォーカス
- 事業ポートフォリオ変革の加速
- 製造業としての強みを活かしたカスタマーゼロを拡大
- グローバル事業拡大(FY2027海外売上収益比率 55%)

	FY2024 <sup>*3</sup>	FY2025 <sup>*3</sup>	FY2026	FY2027
売上成長率 <sup>*1</sup>	YoY +3% [+1%]	YoY ±0% [△1%]	YoY +2% [+2%] (YoY +6%) <sup>*2</sup>	6-8% (6-8%) <sup>*4</sup> FY2024-FY2027 CAGR
Adj. EBITA率	10.2%	11.0%	11.8%	13%超 (13%超)
ROIC	11.5%	12.0%	11.1%	11-13% (11-13%)
Lumada売上収益比率 <sup>*2</sup>	34%	43%	45%	約50% (約45%)

\*1 [ ] 内の数字は、為替影響を除いた値 \*2 新報告セグメントから一部構造改革事業を除いた売上に基づき算出

\*3 FY2024-FY2025の売上成長率、Adj. EBITA率、ROICは新報告セグメントに基づきリステート値

\*4 FY2027の( ) 内の数字は、Hitachi Investor Day 2025(2025年6月11日時点)公表値。新報告セグメントに基づきリステート

**HITACHI**

# 将来予想に関する記述

< 将来の見通しに関するリスク情報 >

本資料における当社の今後の計画、見通し、戦略等の将来予想に関する記述は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等の結果は見通しと大きく異なることがあります。その要因のうち、主なものは以下の通りです。

- ・主要市場における経済状況及び需要の急激な変動
- ・為替相場変動
- ・資金調達環境
- ・株式相場変動
- ・原材料・部品の不足及び価格の変動
- ・信用供与を行った取引先の財政状態
- ・主要市場・事業拠点（特に日本、アジア、米国及び欧州）における政治・社会状況及び貿易規制等各種規制
- ・気候変動対策に関する規制強化等への対応
- ・情報システムへの依存及び機密情報の管理
- ・人財の確保
- ・新技術を用いた製品の開発、タイムリーな市場投入、低コスト生産を実現する当社及び子会社の能力
- ・地震・津波等の自然災害、気候変動、感染症の流行及びテロ・紛争等による政治的・社会的混乱
- ・長期請負契約等における見積り、コストの変動及び契約の解除
- ・価格競争の激化
- ・製品等の需給の変動
- ・製品等の需給、為替相場及び原材料価格の変動並びに原材料・部品の不足に対応する当社及び子会社の能力
- ・コスト構造改革施策の実施
- ・社会イノベーション事業強化に係る戦略
- ・企業買収、事業の合併及び戦略的提携の実施並びにこれらに関連する費用の発生
- ・事業再構築のための施策の実施
- ・持分法適用会社への投資に係る損失
- ・当社、子会社又は持分法適用会社に対する訴訟その他の法的手続
- ・製品やサービスに関する欠陥・瑕疵等
- ・自社の知的財産の保護及び他社の知的財産の利用の確保
- ・退職給付に係る負債の算定における見積り